

108 年度智慧財產人員能力認證商標類試題

類 科：專利檢索分析與加值運用類

全 6 頁

科 目：專利分析

准考證號碼

考試時間：120 分鐘

甲、簡答題部分：(40 分)

- (一) 不必抄題，作答時請將試題題號及答案依照順序寫在試卷上，於本試題作答者，不予計分。
- (二) 請以藍、黑色鋼筆或原子筆在試卷上以中文作答，鉛筆作答不予計分。

一、 (40 分)

「臺灣材料公司」為一準備投入奈米技術產業的國內傳統化學材料製造商，希望透過新建立的奈米材料特性及關鍵技術，開發新產品及改善產品性能，來提升競爭力。資料集「奈米技術.xlsx」為自智慧局全球專利檢索系統(GPSS)輸出之中華民國公告發明專利資料檔並已完成資料清洗與整理(權威控制)。

請回答下列問題：

- (一) 請列出專利件數最多的前三大申請人及其專利數？(10 分)
- (二) 以各專利之第一個 IPC 分類號進行統計，

1. 請列出件數最多的前三大 IPC 四階(Group)分類號及其在

2014/01/01 至 2018/12/31 公告之歷年專利數？(10 分)

2. 請列出其中第一大分類號件數最多的申請人及其專利數？(10 分)

3. 請列出其中第一大分類號件數最多的學術機構申請人及其專利數？(10 分)

乙、申論題部分：(60分)

- (一) 不必抄題，作答時請將試題題號及答案依照順序寫在試卷上，於本試題作答者，不予計分。
- (二) 請以藍、黑色鋼筆或原子筆在申論試卷上以中文作答，鉛筆作答不予計分。

一、 (60分)

Com. B 為一家特殊材料公司，針對其所處「特殊材料」技術領域之美國發明專利，請依據下列分析結果之圖表申論下列問題：

- **提示：1. 不同圖表可能得出不同面向的分析
- 2. 答題請清楚標示所參考的圖表編號

- (一) 「特殊材料」領域發展現況？(10分)
- (二) Com. B 與競爭者的發展現況？(10分)
- (三) Com. B 與 Com. A 技術布局差異？(10分)
- (四) Com. B 與 Com. A 在國際布局之相似與相異處？(15分)
- (五) 由技術互補的角度分析，Com. B 的最佳併購對象。(15分)

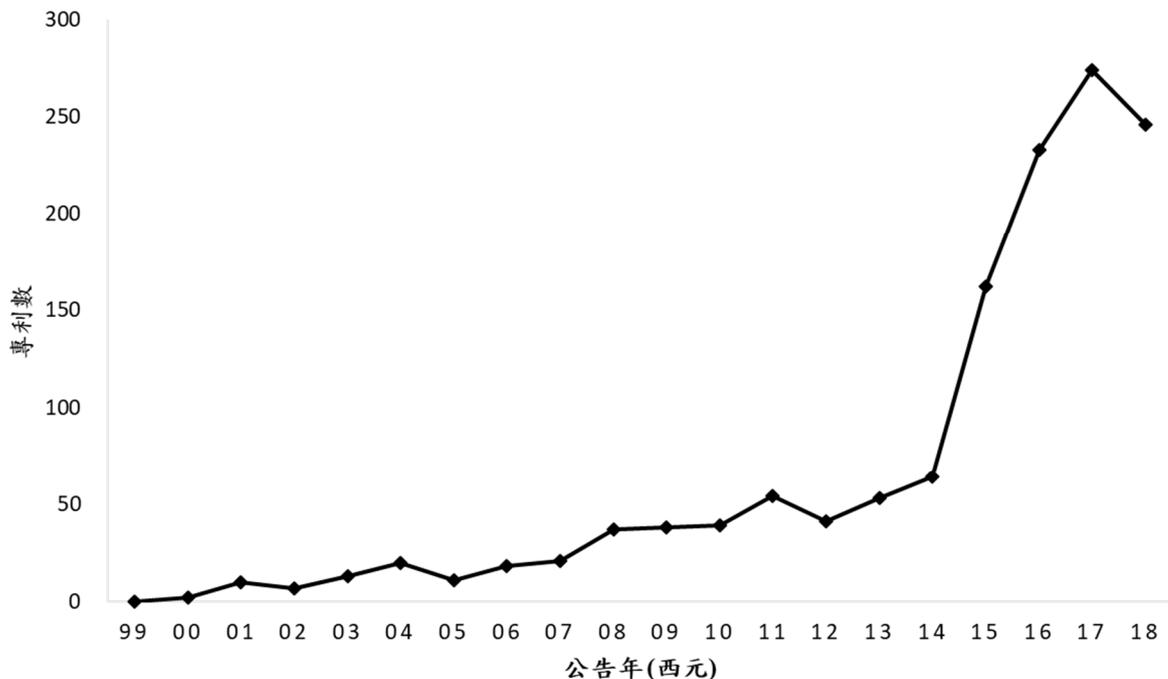


圖1. 特殊材料領域歷年美國公告專利數

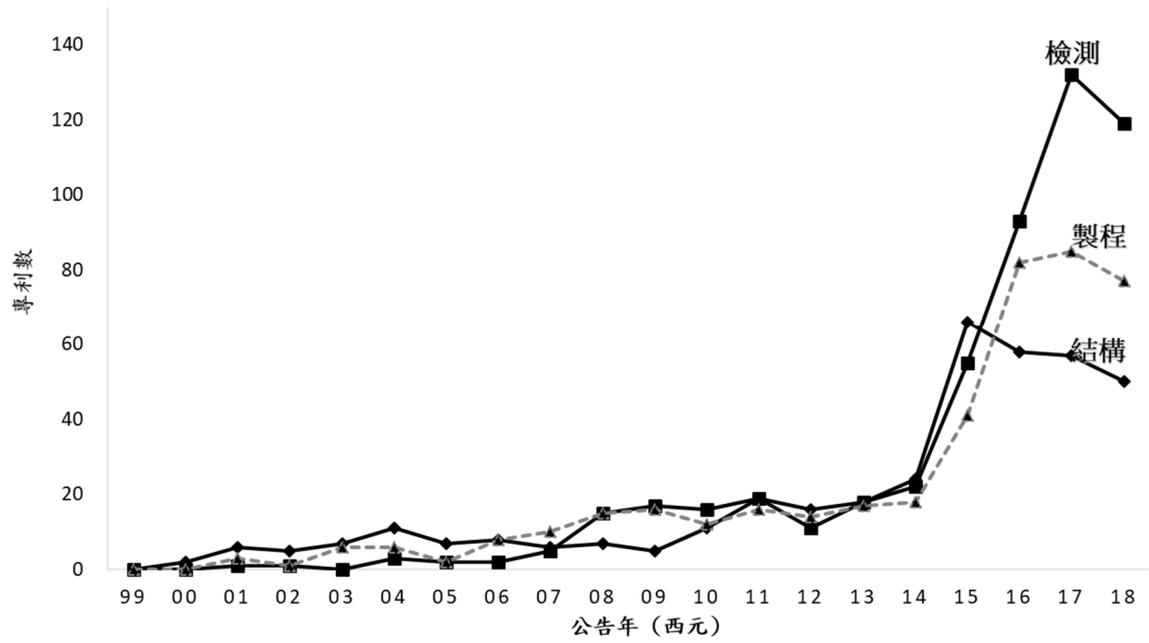


圖2. 特殊材料次領域歷年美國公告專利數

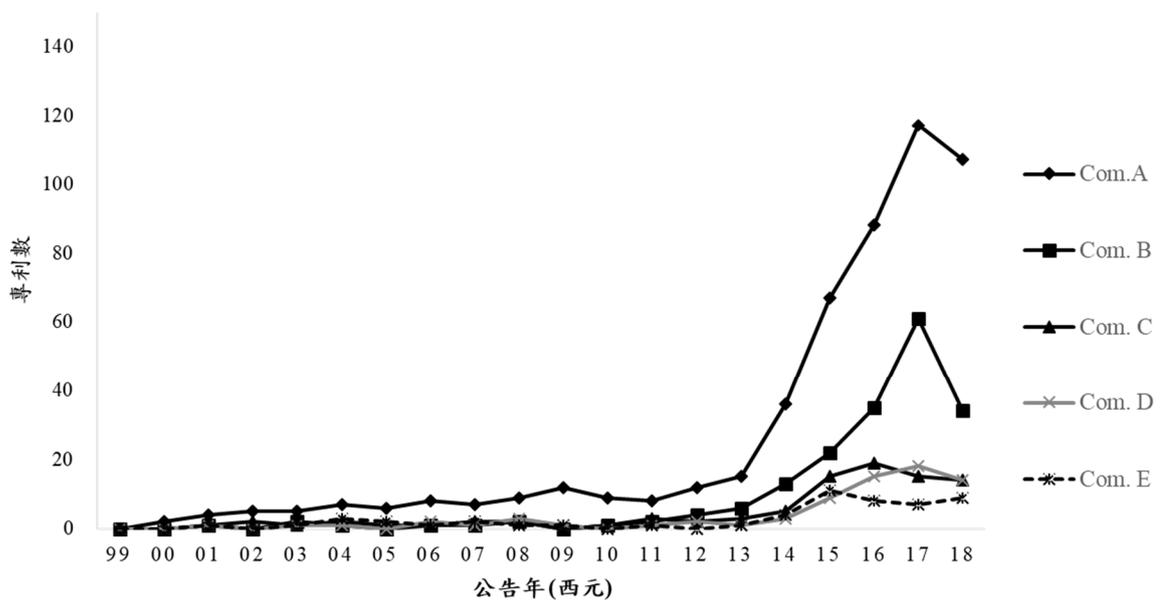
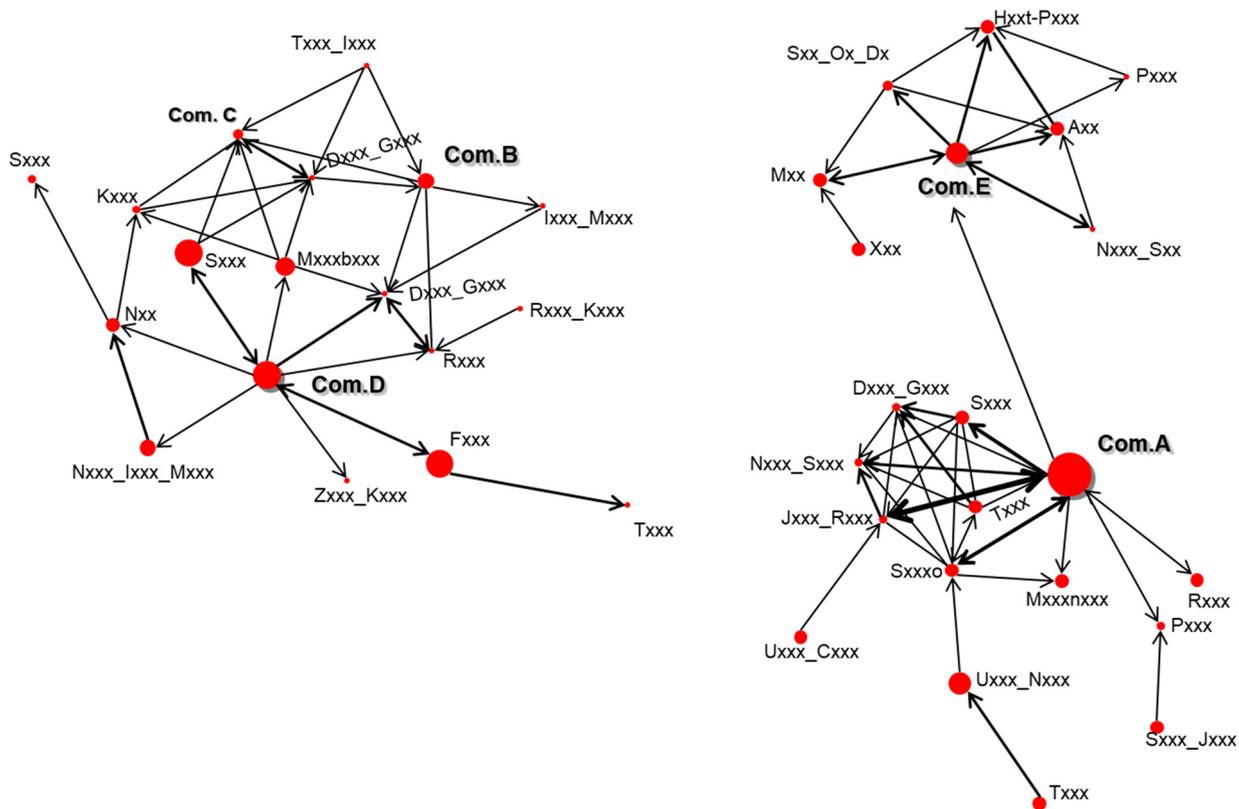


圖3. 前五大申請人 歷年美國公告專利數



箭頭方向：申請人專利被引者→申請人專利引用者、
雙箭頭代表兩申請人專利彼此相互引用

圖4. 申請人專利引用網絡

表1. 前五大申請人件數表現

申請人	專利數	失效、 期滿件數	活動年期 ^註	發明人數	平均專利 年齡
Com.A	524	48	19	318	4.3
Com. B	186	14	18	72	3.3
Com. C	89	11	18	41	4.7
Com. D	73	4	18	111	4.2
Com. E	53	4	18	38	5.5

註：活動年期為該公司最早的專利公告年度至最新的專利公告年度之專利期間

表2. 前五大申請人之發明人表現

項次	申請人	專利件數(%)		發明人數(%)		每位發明人擁有專利數 (a/b)
		(a)		(b)		
1	Com.A	524	43.63%	318	23.87%	1.6
2	Com. B	186	15.49%	72	5.41%	2.6
3	Com. C	89	7.41%	41	3.08%	2.2
4	Com. D	73	6.08%	111	8.33%	0.7
5	Com. E	53	4.41%	38	2.85%	1.4
領域總件數		1,201	100%	1,332	100%	0.9

表3. 前五大申請人被引表現

項次	申請人	專利數	被引用		被引用篇數		被引用次數	
			篇數	次數	自我	他人	自我	他人
1	Com.A	524	122	1,340	39	83	328	1,012
2	Com. B	186	101	621	9	92	117	504
3	Com. C	89	15	82	3	12	12	70
4	Com. D	73	24	480	9	15	197	283
5	Com. E	53	26	312	10	16	129	183

表4. 前五大申請人專利家族分佈

申請人	專利數	專利家族數	專利家族在各國分布數					
			US	TW	EP	JP	CN	其他國家
Com.A	524	258	258	18	211	12	20	5
Com. B	186	64	63	47	34	10	30	2
Com. C	89	40	38	6	18	1	23	3
Com. D	73	21	20	17	18	2	11	5
Com. E	53	22	22	5	19	2	4	1

表5. 技術/功效矩陣專利件數

技術分類 \ 功效分類		應用領域		產品優化			
		電晶體	再生醫療	縮短生產週期	提升效率	降低功耗	高密度
結構	聚合系統	50	128	42			11
	複合材料	45	38	32	12	20	5
製程	DUV光刻			108	62	55	
	EUV光刻			122	70	12	
檢測	微結構		57	144	14	43	20
	化學鍵結特性		80	115	18	35	5

表6. 技術/功效矩陣申請人分布

技術分類 \ 功效分類		應用領域		產品優化			
		電晶體	再生醫療	縮短生產週期	提升效率	降低功耗	高密度
結構	聚合系統	Com.A(50)	Com.A(29) Com.B(43)	Com.A(42)			Com.A(4)
	複合材料	Com.A(13)	Com.A(30)	Com.A(12)	Com.A(9)	Com.A(10) Com.E(9)	Com.A(3)
製程	DUV光刻			Com.B(46) Com.C(21) Com.D(19)	Com.B(25) Com.C(17)	Com.B(34) Com.C(21)	
	EUV光刻			Com.D(68) Com.E(38)	Com.A(57) Com.D(5)	Com.A(6) Com.D(4)	
檢測	微結構		Com.A(65) Com.D(32)	Com.E(48)	Com.C(4) Com.D(22)	Com.C(15)	Com.C(11)
	化學鍵結特性		Com.D(19) Com.E(37)	Com.E(69)	Com.E(4)	Com.E(8)	Com.A(4)